

CBW-Serie

Bondbare Chipwiderstände, unmagnetisch

Baugrößen: 0402, 0603, 0805, 1206

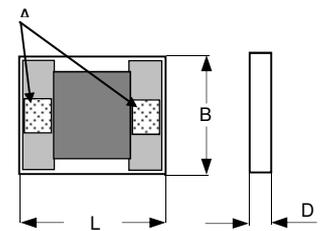
Merkmale:

- Chipwiderstände in Dickschicht-Technik
- AgPd-Terminierung für Face-down Montage (Flip Chip; für Leitkleber geeignet) oder
- Gold-Terminierung für Face-up Montage (drahtbondbar US/TC)
- Keine Umkontaktierung
- Unmagnetisch



Abmessungen:

Baugröße	L	B	D	A _{min}
0402	1,04 ±0,05	0,50 ±0,05	0,30 +0,15/-0,05	0,15 x 0,15
0603	1,50 +0,15/-0,05	0,80 +0,15/-0,05	0,40 +0,15/-0,05	0,20 x 0,20
0805	2,00 +0,15/-0,05	1,25 +0,15/-0,05	0,40 +0,15/-0,05	0,25 x 0,25
1206	3,20 +0,15/-0,05	1,50 +0,2/-0,05	0,40 +0,15/-0,05	0,30 x 0,30



L = Länge, B = Breite, D = Dicke, A = Bondpad (in mm), andere Baugrößen auf Anfrage

Lieferformen:

Schüttgut in Plastikbeuteln – ab 100 Stück/Wert

Waffle-Pack / GelTray (2“) – ab 100 Stück/Wert

Im Blistergurt nach IEC 60286-3 – ab 500 Stück/Wert (nicht für 0402)

Spulendurchmesser 180 mm oder 330 mm

Lage im Gurt: Face-up für Drahtbond-Anwendung
Face-down für Flip-Chip-Anwendung

Bestellangaben:

Gold-Terminierung für Face-up Montage (Bonden)

Typ – Wert – Toleranz – TK - Terminierung

Beispiel: CBW 0603 100K ±5% TK100 Au

AgPd-Terminierung für Face-down Montage (Flip Chip)

Typ – Wert – Toleranz – TK

Beispiel: CBW 0603 1G ±20% TK1000

Falls keine Angaben zu TK und Verpackung vorliegen, werden die Standardwerte (TK größter Wert) angenommen und Schüttgut geliefert. Ohne Spezifikation wird als Terminierung AgPd für Flip-Chip-Anwendung eingesetzt.

CBW-Serie

Bondbare Chipwiderstände, unmagnetisch

Baugrößen: 0402, 0603, 0805, 1206

Technische Daten - baugrößenabhängig:

Baugröße	0402	0603	0805	1206
Belastbarkeit P ₇₀ (mW) (P ₁₅₅ = 0 mW)	50	100	125	250
Max.Nennspannung U ₋ , U _{eff} (V)	60	150	200	400

Wertebereich / Toleranz / TK ¹⁾ / VCR ²⁾				
10R – 10M	5/10/20% TK100/250	5/10/20% TK50/100	5/10/20% TK50/100	5/10/20% TK50/100
>10M – 100M	5/10/20% TK100/250	5/10/20% TK50/100	5/10/20% TK50/100	5/10/20% TK50/100
>100M – 1G	10/20/30% TK500/1000	5/10/20% TK250/500	5/10/20% TK250/500	5/10/20% TK100/250
>1G – 10G	10/20/30% TK2000	5/10/20% TK500/1000	5/10/20% TK500/1000	5/10/20% TK250/500
>10G – 100G	10/20/30% TK2000	10/20/30% TK2000/3000	10/20/30% TK2000/3000	5/10/20% TK500/1000
>100G – 1T	-	20/30/50% TK3000	10/20/30% TK3000	10/20/30% TK2000

Andere Werte, Toleranzen, TK und VCR auf Anfrage

¹⁾ TK: in ppm/K; +25 °C...+125 °C; bei TK kleiner als Standard (größter Wert) und R>100G: +25 °C...+85 °C

²⁾ VCR: typische Werte, alle Werte negativ, nicht für alle TK-Werte möglich

Technische Daten - allgemein:

Arbeitstemperaturbereich	-55 °C ... +155 °C
Klimakategorie nach DIN EN 60068-1	55/155/56

Langzeitstabilität	< 10M	10M - 1G	1G - 10G	≥10G
Lagerung 125 °C/1000h	< 0,5%	<1%	<2%	<5%
Maximale Spannung/1000h	< 0,5%	<0,5%	<1%	<2%
Kurzzeitüberlast (2,5-fach, 5s)	< 0,25%			

Daten, soweit nicht spezifiziert, nach EN 140401-802 (CECC 40401-802).

SIEGERT TFT GmbH

Robert-Friese-Straße 3

07629 Hermsdorf / Germany

Tel.: +49 36601 858 0

Fax: +49 36601 858 11

E-Mail: info@siegert-tft.de

www.siegert-tft.de